MAGNETIC BUBBLE MEMORY CHIP

Publication number: JP58171783

Publication date:

1983-10-08

Inventor:

HIROSHIMA MINORU

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

G11C11/14; G11C19/08; G11C11/02; G11C19/00;

(IPC1-7): G11C11/14

- European:

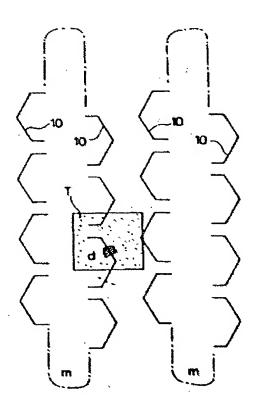
G11C19/08

Application number: JP19820053858 19820402 Priority number(s): JP19820053858 19820402

Report a data error here

Abstract of JP58171783

PURPOSE:To relieve a chip having a creative defect, by irradiating the part of the new creative defect of the chip with a laser light and applying a thermal stress to it to confine the creative defect. CONSTITUTION:If a new creative defect (d) exists, the peripheral part including this defect is subjected to the confining treatment to confine the new creative defect, and the influence of the new creative defect upon other areas is prevented. A thermal stress T is applied by irradiation of a laser spot light in the confining treatment, and bubble transfer is possible. Thus, even the chip having the new creative defect is used.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

四58-171783

①Int. Cl.³ G 11 C 11/14 19/08 識別記号

庁内整理番号 7341-5B 7343-5B 砂公開 昭和58年(1983)10月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

函磁気パブルメモリチップ

②特 額 昭57-53858

②出 願 昭57(1982)4月2日

⑩発 明 者 廣島質

茂原市早野3300番地株式会社日

立製作所茂原工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

⑩代 理 人 弁理士 薄田利幸

明細 審

発明の名称 ・磁気パプルメモリチツブ . 特許請求の範囲

チップのニュークリエート性欠陥部化、レーザスポットによつてサーマルストレスを加えることにより欠陥を封じ込めた磁気パブルメモリチップ。 発明の詳細な説明

本発明は磁気パプルメモリチツブに関するもの である。

第1図に田気パブルメモリチツブの構成図の1例を示す。同図において田は情報を貯える複数のマイナループ、RLは出力情報を転送するライトライン、WLは入力情報を転送するライトラインである。また、Dは磁気パブルを電気信号に変換するパブル検出器、Oは情報を書き込む缶気パブル発生器、Rはマイナループmの情報をリードラインRLに被写するレプリケートゲート、8はライトラインWL上の情報とマイナループ中の情報を入れ替えるスワツブゲートである。

このように磁気パブルメモリチツブは多数盤の

マイナルーブmを持ち、チツブの全体面積の 6 0 %~ 9 0 % はこのマイナルーブ m で占められている。マイナルーブ m の数 l は、 6 4 kb チツブの 場合 1 0 0 ~ 1 5 0 個あ b、 2 5 6 kb チツブでは、 2 5 0 ~ 3 0 0 個、 1 Mb チツブでは 5 5 0 ~ 8 0 0 個 ある。

このよりな磁気パブルメモリチツブを実際に作 製した場合、無欠陥のチツブばかり作製すること はできず、多くのものはチツブ内に機つかの欠陥 を持つ。欠陥はチツブ内でランダムに発生するた め、これらの欠陥のほとんどすべてはマイナルー ブ皿上に生じる。すなわち作製された多くのチツ ブは、欠陥すのあるマイナルーブ(欠陥ループと 呼ぶ)を機つか持つことになる。

.....

7 FPOI-044-07W-HP

OA

-529- FATT

特開昭58-171783(2)

6 4 k b チップの場合 4 ~ 1 0 個 . 25 6 k b チップの場合 2 0 ~ 3 0 個 . 1 M b チップの場合 5 0 ~ 6 0 個用意される。

とのように磁気パブルメモリチツブは、マイナルーブに欠陥ループがあつても、その数が。 個まで許容できる構成になつている。 すなわち、欠陥ループ数が。 個以内であれば、そのチップは合格となり、(3+1)倒以上であればそのチップは不合格になる構成になつていた。

ところが、欠陥ループ数が ● 個以内の合格となるべきチップのあるものは、次のような問題を持つ。

欠陥ループで調動作をする場合、この調動作の 権類は欠陥の種類に対応して次の3種類がある。 すなわち普良込んだ研気パブルが消滅する消滅性 欠陥ループ・普良込んだ研気パブルが分裂する分 裂性欠陥ループ・そして研気パブルを一個も普良 込まなくても曲気パブルを消を出すニュークリエ ート性欠陥ループである。ニュークリエート性欠 陥ループは、欠陥部分で田気パブルがニュークリ

がつて、欠陥ループ数が許容ループ数 * 個以内で も、ニユークリエート性欠陥ループがチツプ内に 一個でも存在していると、そのチップは使用でき ないことになる。

本発明の目的は、ニュークリエート性欠陥ルーブがあり、かつそのチツブを長時間動作しても、 上記試動作の起こらないようにした田気パブルメ モリチツブを提供しようとするものである。

以下、本発明を詳細に観明する。

本発明の基本的を考え方は、ニュークリエート性の欠陥があつた場合、この欠陥を含めて、この 周辺部に次に述べる処理を行なうととにより、この欠陥を隠離しようとするものである。すなわち、 この処理により、ニュークリエート性欠陥を閉じ 込めようとするものである。欠陥から新らしく個 気パブルが生まれても、その母気パブルが、この 領域内に到じ込められて、他の領域へ放及しない ようにしようとするものである。

との封じ込み処理は、レーザスポット光を利用 して、欠陥部にサーマルストレスを加えることに エーション (新しく発生)されることによつて起 とる。

したがつてニュークリエート性欠陥ループは、 チップにとつて致命的な欠陥ループとなる。した

より容易に処理することができる。

サーマルストレスにより、その部分で磁気パブルの転送が完全に阻止され、それより先へのパブル転送が不能となり、パブル對じ込みができるわけである。

以下、本発明を実施例により説明する。

第2図は本発明による実施例を説明する図である。同図において、mはマイナループ、10はマイナループを形成する磁気パブル転送要素、dはニュークリエート性欠陥である。Tはレーザビームでサーマルストレスを加えた部分である。Cれにより、dから新らしく生まれた磁気パブルは、Cの領域Tの内部に對じ込められ、Cの外部へはのでを完全に防止できた。Cれにより、Cれら2つのマイナループは、欠陥ループとなるだけで済み、致命的な欠陥と様ならない。すなわち、Cのチンプは、正常チンプとして使用できる。

以上説明した如く楽器明によれば、ニュークリ エート性欠陥が存在しても、それを到じ込めることにより、そのチップを正常チップとして使用す ることが可能となる。

図面の簡単な説明

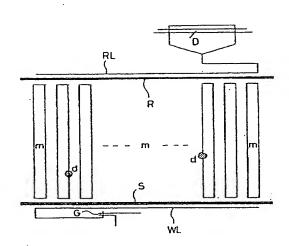
第1図は磁気パブルメモリチツブの構成図の一例を示す図、第2図は本発明の一実施例を観明する図である。

10・・・・ 磁気パブル転送要素、m・・・・マイナループ、d・・・・ニュークリエート性欠陥、T・・・サーマルストレスを加えた領域。

代理人 弁理士 群 田 利 幸

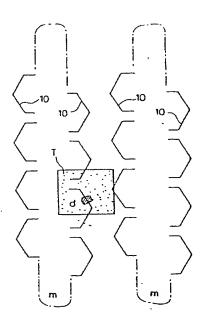


第1図



:57.

第 2 図



PAT-NO:

JP358171783A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58171783 A

TITLE:

MAGNETIC BUBBLE MEMORY CHIP

PUBN-DATE:

October 8, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIROSHIMA, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP57053858

APPL-DATE:

April 2, 1982

INT-CL (IPC): G11C011/14, G11C019/08

US-CL-CURRENT: 365/1

ABSTRACT:

PURPOSE: To relieve a chip having a <u>creative defect</u>, by irradiating the part of the new <u>creative defect</u> of the chip with a <u>laser</u> light and applying a thermal stress to it to confine the <u>creative defect</u>.

CONSTITUTION: If a new creative defect (d) exists, the peripheral part including this defect is subjected to the confining treatment to confine the new creative defect, and the influence of the new creative defect upon other areas is prevented. A thermal stress T is applied by irradiation of a laser spot light in the confining treatment, and bubble transfer is possible. Thus, even the chip having the new creative defect is used.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

٠....